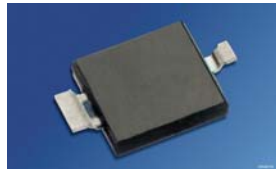


# Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter; in SMT as Reverse Gullwing Si-PIN Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT als Reverse Gullwing Version 1.1

## BPW 34 FASR



### Features:

- Especially suitable for the wavelength range of 730 nm to 1100 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- DIL plastic package with high packing density
- Suitable for reflow soldering

### Applications

- Photointerrupters
- IR remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote controls of various equipment
- Automotive (eg rain sensor, headset)

### Besondere Merkmale:

- Speziell geeignet für den Wellenlängenbereich von 730 nm bis 1100 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- DIL-Plastikbauf orm mit hoher Packungsdichte
- Geeignet für Reflow L öten

### Anwendungen

- Lichtschranken
- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
- Automotomobil (z.B. Regensensor, Headset)

### Ordering Information

#### Bestellinformation

Type:	Photocurrent	Ordering Code
Typ:	Fotostrom	Bestellnummer
	$\lambda = 870 \text{ nm}$ , $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ , $V_R = 5 \text{ V}$ $I_P$ [ $\mu\text{A}$ ]	
BPW 34 FASR	50 ( $\geq 40$ )	Q651 10A2699

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	$V_R$	16	V
Reverse voltage Sperrspannung ( $t < 2\text{ min}$ )	$V_R$	32	V
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	150	mW

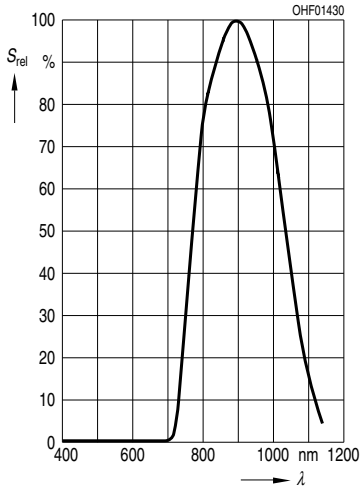
**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent Fotostrom ( $V_R = 5\text{ V}$ , $\lambda = 870\text{ nm}$ , $E_e = 1\text{ mW/cm}^2$ )	$I_P$	50 ( $\geq 40$ )	$\mu\text{A}$
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	880	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	730 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	7.02	$\text{mm}^2$
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche	L x W	2.65 x 2.65	mm x mm
Half angle Halbwinkel	$\phi$	$\pm 60$	°
Dark current Dunkelstrom ( $V_R = 10\text{ V}$ )	$I_R$	2 ( $\leq 30$ )	nA
Spectral sensitivity of the chip Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips ( $\lambda = 870\text{ nm}$ )	$S_{\lambda\text{ typ}}$	0.65	A / W

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Quantum yield of the chip Quantenausbeute des Chips ( $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	$\eta$	0.93	Electro ns /Photon
Open-circuit voltage Leerlaufspannung ( $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	$V_O$	320 ( $\geq 250$ )	mV
Short-circuit current Kurzschlussstrom ( $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	$I_{SC}$	23	$\mu\text{A}$
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ( $V_R = 5 \text{ V}$ , $R_L = 50 \Omega$ , $\lambda = 850 \text{ nm}$ , $I_p = 800 \mu\text{A}$ )	$t_r, t_f$	0.02	$\mu\text{s}$
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 100 \text{ mA}$ , $E = 0$ )	$V_F$	1.3	V
Capacitance Kapazität ( $V_R = 0 \text{ V}$ , $f = 1 \text{ MHz}$ , $E = 0$ )	$C_0$	72	pF
Temperature coefficient of $V_O$ Temperaturkoeffizient von $V_O$	$TC_V$	-2.6	mV / K
Temperature coefficient of $I_{SC}$ Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ ( $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	$TC_I$	0.03	% / K
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung ( $V_R = 10 \text{ V}$ , $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	NEP	0.039	pW / $\text{Hz}^{1/2}$
Detection limit Nachweisgrenze ( $V_R = 10 \text{ V}$ , $\lambda = 870 \text{ nm}$ )	$D^*$	6.8e12	$\text{cm x}$ $\text{Hz}^{1/2} / \text{W}$

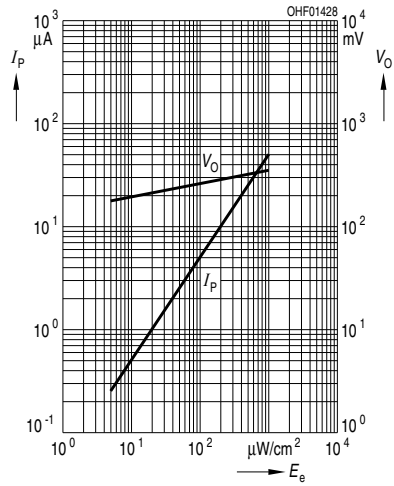
**Relative Spectral Sensitivity**  
**Relative spektrale Empfindlichkeit**

$S_{rel} = f(\lambda)$



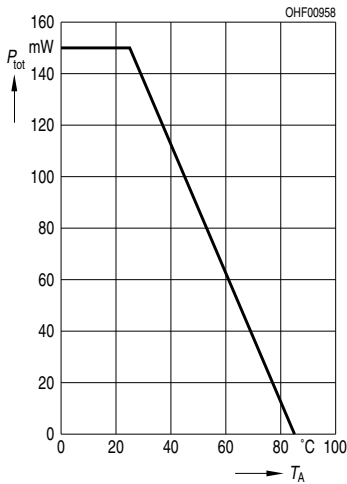
**Photocurrent / Open-Circuit Voltage**  
**Fotostrom / Leerlaufspannung**

$I_p (V_R = 5 V) / V_O = f(E_e)$



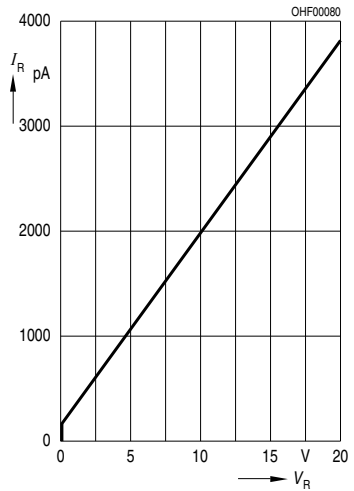
**Total Power Dissipation**  
**Verlustleistung**

$P_{tot} = f(T_A)$



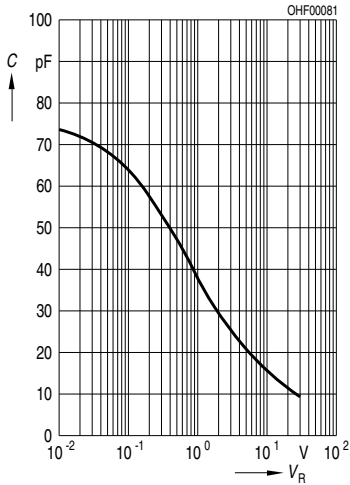
**Dark Current**  
**Dunkelstrom**

$I_R = f(V_R), E = 0$



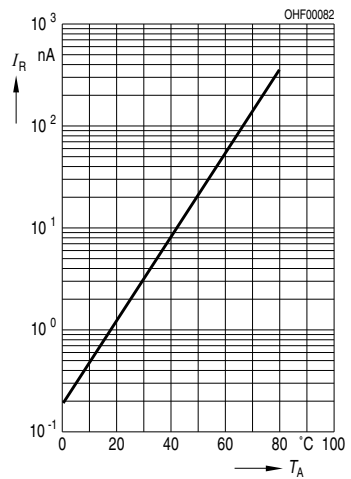
### Capacitance Kapazität

$$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$



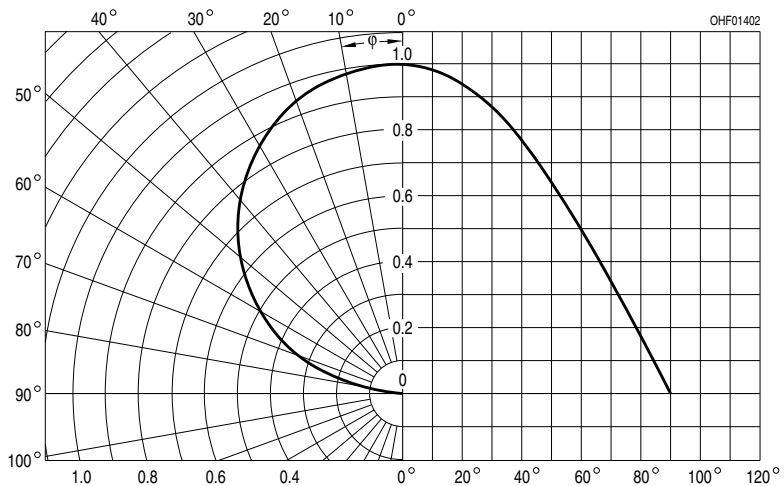
### Dark Current Dunkelstrom

$$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$$

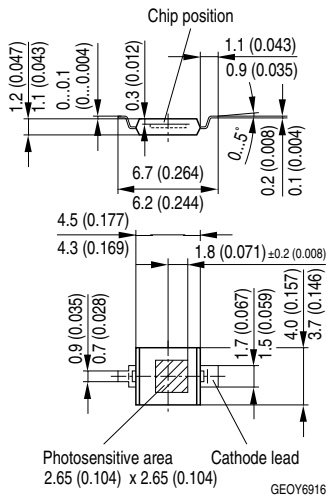


### Directional Characteristics Winkeldiagramm

$$S_{\text{rel}} = f(\varphi)$$



**Package Outline  
Maßzeichnung**



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

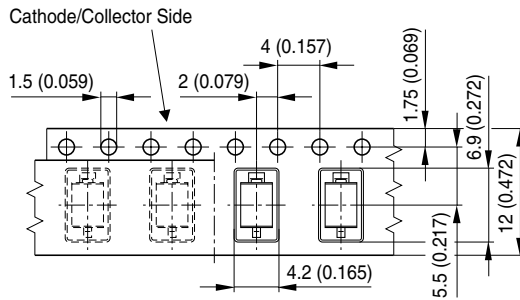
**Package**

SMT DIL, Epoxy

**Gehäuse**

SMT DIL, Harz

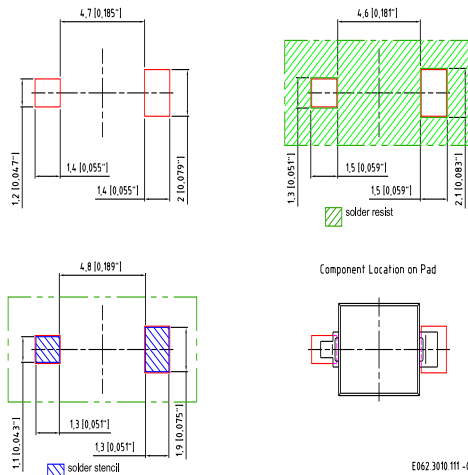
## Method of Taping Gürtung



OHAY6684

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

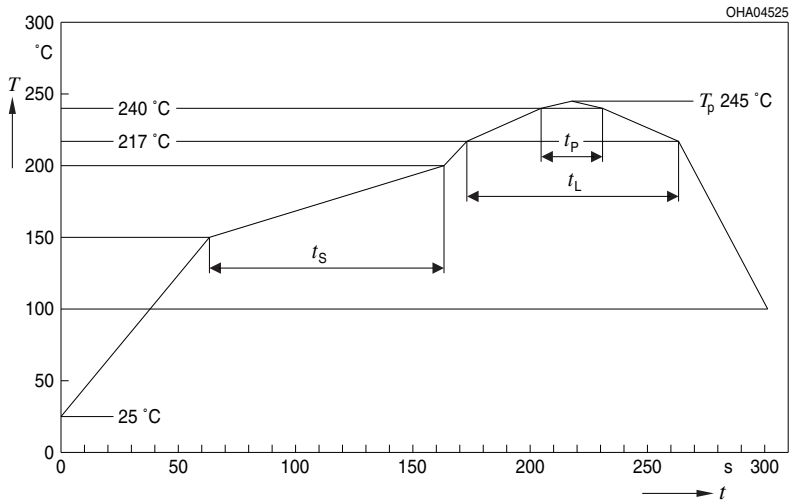
## Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpadding



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Reflow Soldering Profile****Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_s$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{Smax}$ to $T_p$			2	3	K/s
Liquidus temperature	$T_L$	217			°C
Time above liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak temperature	$T_p$		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_p$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_p$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range



## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。